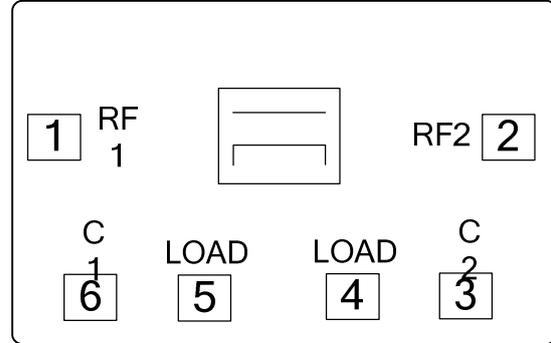




### 主要特点

- 工作频率: 2-6 GHz
- 插入损耗: 0.3 dB
- 耦合度: 20 dB
- 耦合度平坦度:  $\pm 1.2$  dB
- 芯片尺寸:  $3.0 \times 1.0 \times 0.1 \text{ mm}^3$

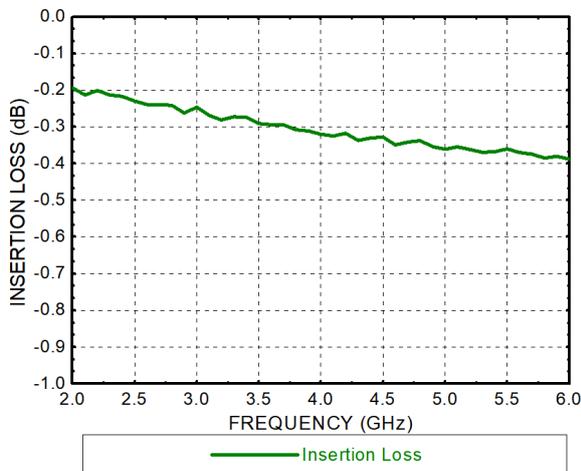
### 功能框图



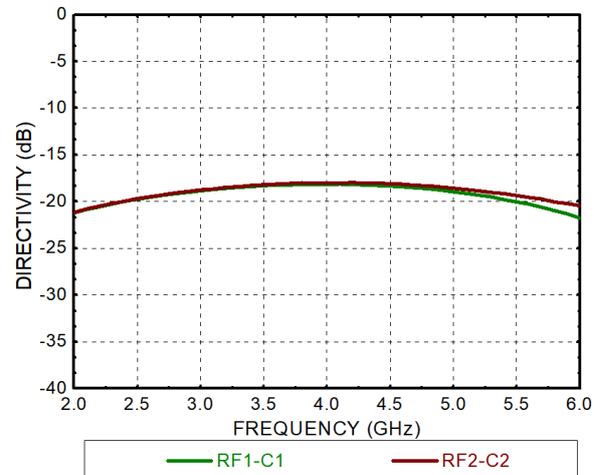
### 性能指标 ( $T_A = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ )

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	2 - 6			GHz
插入损耗		0.3		dB
耦合度		20		dB
耦合度平坦度		$\pm 1.2$		dB
端口回波损耗		25		dB
隔离度		35		dB

### 插入损耗

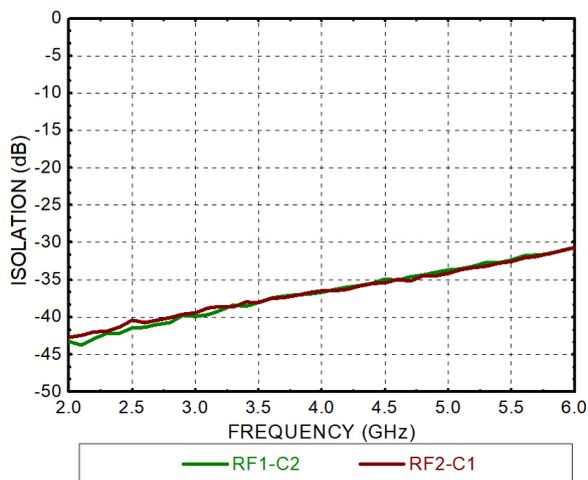


### 耦合度

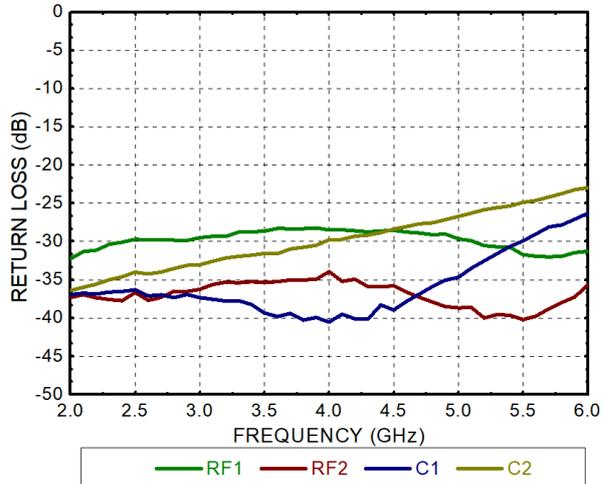




## 隔离度



## 回波损耗



## 物理参数

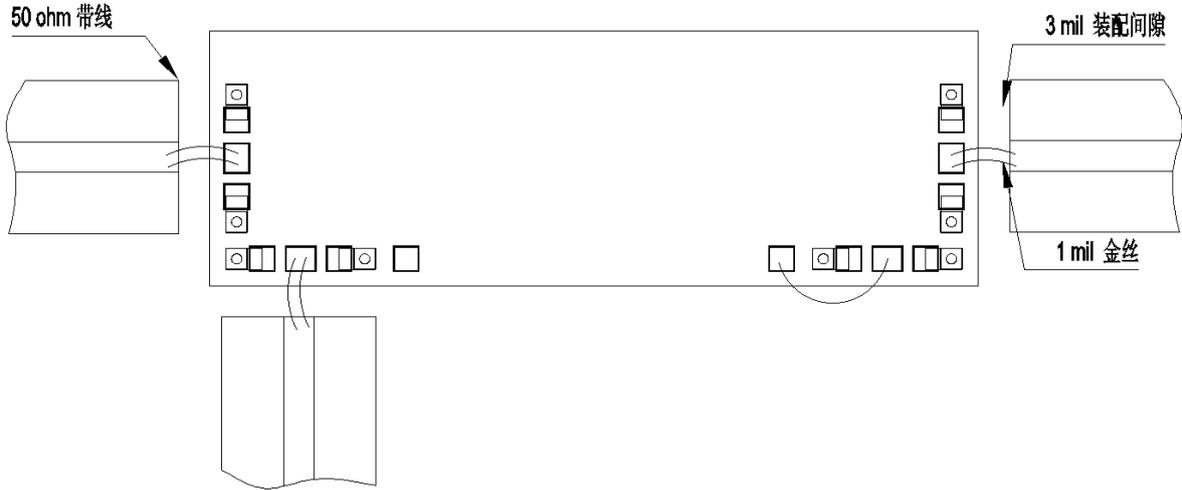


## 焊盘描述

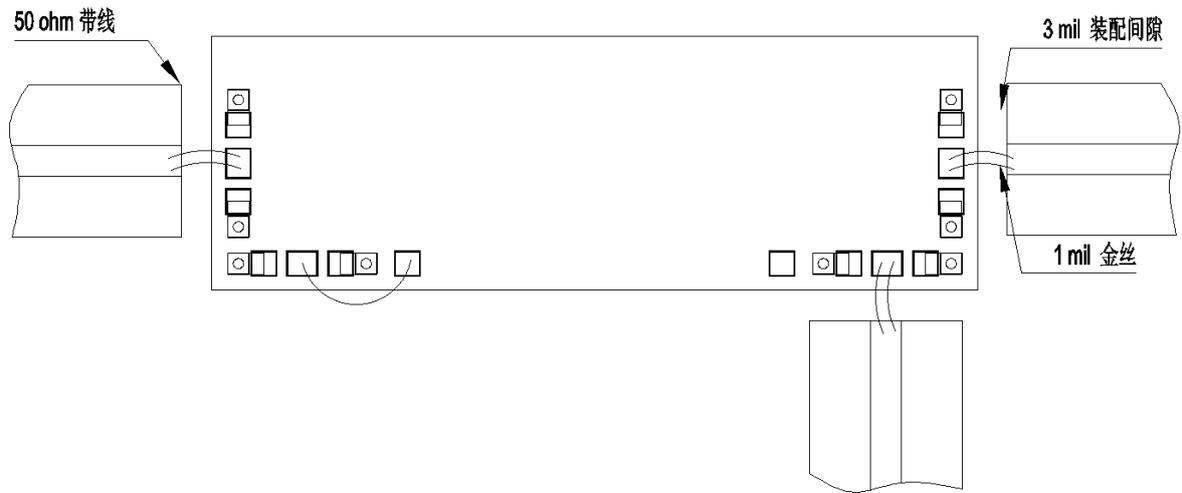
焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频信号正向输入端口, 反向输出端口
2	RF2	该焊盘是射频信号正向输出端口, 反向输入端口
6	C1	该焊盘是正向耦合端口
3	C2	该焊盘是反向耦合端口
4, 5	LOAD	该焊盘是 50Ω负载端口
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



推荐电路图@正向使用时



推荐电路图@反向使用时



注意事项

1. 本芯片属于静电敏感器件，运输、存储和使用过程中注意静电防护
2. 芯片厚度为 100  $\mu\text{m}$
3. 典型键合焊盘尺寸为 120\*100  $\mu\text{m}^2$
4. 键合焊盘金属化：金
5. 芯片背面镀金
6. 芯片背面接地
7. 未标注的键合焊盘不需要连接
8. 钝化层信息：材质：SiN+PBO；厚度：0.5+1.6  $\mu\text{m}$

极限参数

1. 射频输入功率：+43 dBm
2. 储存温度：-65 ~ +150  $^{\circ}\text{C}$
3. 工作温度：-55 ~ +85  $^{\circ}\text{C}$